

成都高新投资集团有限公司出售转让 资产的公告

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为进一步深化改革，提升公司经营效能，成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）下属全资子公司成都高投电子信息产业集团有限公司转让其持有的成都积体半导体有限责任公司 100%的股权，并以非公开协议方式转让。

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易标的资产总价值占发行人合并报表范围上年末资产总额未达到 50%以上，标的资产上年度实现的营业收入占发行人合并报表范围同期营业收入未达到 50%以上，标的资产净额占发行人合并报表范围上年末净资产未达到 50%以上，不构成重大资产重组。

二、交易标的情况

（一）标的基本情况

公司名称：成都积体半导体有限责任公司

成立时间：2020 年 9 月 28 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：魏靖

经营范围：销售电子元器件、集成电路、集成电路芯片及产品、电子产品、机械设备、计算机、软硬件及其辅助设备。

发行人持股比例：在本次股份转让前，高投集团持股比例 100%。

（二）标的主要财务情况

根据《成都积体半导体有限责任公司 2023 年度审计报告》（川华信审[2024]第 0068-006 号），成都积体半导体有限责任公司主要财务情况如下：

单位：亿元

项目	2023 年度
资产总额	31.64
负债总额	24.44
所有者权益	7.2
归属于母公司的股东权益	-0.88
净利润	2.91

三、交易合同的主要内容

截止本公告出具日，高投集团全资子公司成都高投电子信息产业集团有限公司已就本次交易与成都高新集萃科技有限公司签署交易文件。

（一）合同主体

转让方：成都高投电子信息产业集团有限公司

受让方：成都高新集萃科技有限公司

（二）转让标的

本次协议转让的标的股权为成都高投电子信息产业集团有限公司持有的成都积体半导体有限责任公司 100% 股权。

四、相关决策情况

此次股权转让事项已经高投集团董事会审议通过并完成工商变更。

五、影响分析和应对措施

本次出售转让资产为公司正常处置资产行为，本次出售转让资产不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司出售转让资产的公告》盖章页）。

成都高新投资集团有限公司

2024年7月22日

